

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 6 月 5 日(05.06.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/084288 A1

- (51) 国際特許分類:
G02B 5/22 (2006.01) *H01L 27/14* (2006.01)
C08L 101/00 (2006.01) *H04N 5/225* (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01) *H04N 5/335* (2011.01)
C09D 201/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/081979
- (22) 国際出願日: 2013 年 11 月 27 日(27.11.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-263643 2012 年 11 月 30 日(30.11.2012) JP
- (71) 出願人: 富士フイルム株式会社(FUJIFILM CORPORATION) [JP/JP]; 〒1068620 東京都港区西麻布 2 丁目 2 6 番 3 0 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 江副 利秀(EZOE Toshihide); 〒4210396 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士フイルム株式会社内 Shizuoka (JP). 嶋田 和人(SHIMADA Kazuto); 〒4210396 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士フイルム株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 高松 猛, 外(TAKAMATSU Takeshi et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目 7 番 1 3 号
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CURABLE RESIN COMPOSITION, AND IMAGE-SENSOR-CHIP PRODUCTION METHOD AND IMAGE SENSOR CHIP USING SAME

(54) 発明の名称: 硬化性樹脂組成物、これを用いたイメージセンサチップの製造方法及びイメージセンサチップ

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a curable resin composition with which an image sensor chip in which colour shading is inhibited can be produced; and an image-sensor-chip production method and an image sensor chip in which said curable resin composition is used. Provided is a curable resin composition which can be applied upon a solid-state-imaging-element substrate, and which includes a pigment having a maximum absorption wavelength in the wavelength range 600-850 nm. Also provided are an image-sensor-chip production method and an image sensor chip in which said curable resin composition is used.

(57) 要約: カラーシェーディングが抑制されたイメージセンサチップを作製可能な硬化性樹脂組成物、これを用いたイメージセンサチップの製造方法及びイメージセンサチップを提供する。固体撮像素子基板上に塗布し得る波長 600~850 nm の範囲内に極大吸収波長を有する色素を含有する硬化性樹脂組成物、これを用いたイメージセンサチップの製造方法及びイメージセンサチップ。



WO 2014/084288 A1